



## R.C. MICROELECTRÓNICA S.A.

Francesc Moragas, nº72. Nave 3 08907 HOSPITALET DE LL. (BCN) TEL.34 - 93 260 21 66 FAX. 34 - 93 338 36 02  
Castrobarco 10 28042 MADRID TEL.34 - 91 329 55 08 FAX. 34 - 91 329 45 31  
Sierra de Aralar, 64 20014 SAN SEBASTIAN TEL.34 - 94 345 92 46 FAX. 34 - 94 347 32 20

### NOVEDADES ASSMANN

ASUNTO: Nuevo catálogo *Thermal Management Products*.

Assmann electronic components ha presentado recientemente el nuevo catálogo de thermal management products, en el que aparece una amplia gama de radiadores y soluciones para mejorar la disipación térmica de la mayoría de encapsulados estándar de la industria.

La gama de productos que aparece en este nuevo catálogo está formada por:

#### *Finger-Shaped heatsinks*

Radiadores estándar, tanto para circuitos integrados DIP (hasta 40 pines) como en forma U para encapsulados TO-220 y SOT-32. En este apartado hay modelos dotados de pines que permiten fijar el radiador al circuito impreso, mejorando la estabilidad y fijación del conjunto encapsulado - radiador. También en este apartado aparecen radiadores especiales para encapsulados KLF, TO-3, TO-66 y SOT-32 e incluso para encapsulados SMD como DPAK o D<sup>2</sup>PAK.



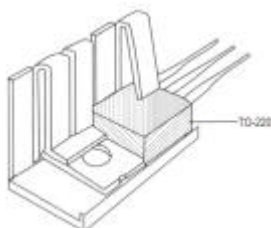
Radiador TO-220



Radiador DPAK

#### *Attachable heatsinks.*

En este apartado se engloban todos aquellos radiadores que permiten la fijación del componente al radiador sin necesidad de tornillos o adhesivos, mediante un pin o mecanismo de retención integrado en el propio radiador. Este tipo de radiadores está disponible en diversas configuraciones y en versiones con o sin pines para soldar al circuito impreso. También los hay circulares para encapsulados tipo TO-XX.



Radiador con clip TO-220



Radiador TO-5



kit aislante térmico



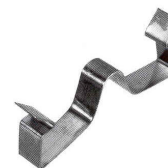
pad conductor TO-220

#### *Extruded heatsinks with solder pins*

Radiadores extrusionados para encapsulados TO-220, TOP-3, SOT-32 en diferentes tamaños y formas, con o sin pines. También están disponibles clips retenedores que posibilitan la fijación del componente al radiador sin necesidad de tornillos o adhesivos.



Radiador con pines



clip de sujeción



Radiador 3 encapsulados

Dejando a un lado la gama de radiadores, en este catálogo aparecen también compuestos adhesivos para fijar los radiadores a los componentes, compuestos para mejorar la conductividad térmica entre radiador y componente, pads cerámicos, de mica, de óxido de aluminio o de óxido de Berilio e incluso kits formados por tornillo, tuerca, arandela y utilizados para aislar térmicamente los componentes del circuito impreso.